

Platinen

Anwendungsbereich
Embedded Systems

Eigenschaften

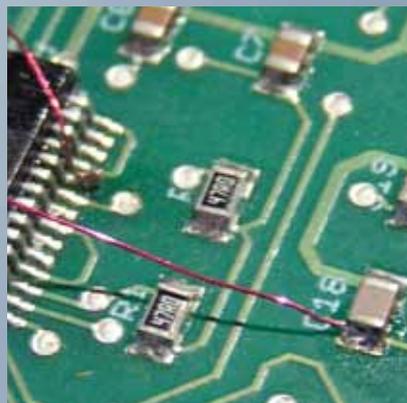
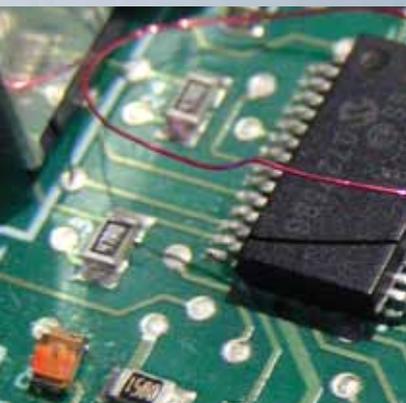
- Perfekt abgestimmtes Verpackungssystem für viele Leiterkartenformate
- Auch mit ESD- Folie und ESD- Wellpappe erhältlich

Vorteile

- Sicherer Versandschutz für hochwertige Leiterkarten
- Schutz vor elektrostatischer Aufladung
- Schnelle Verpackzeiten
- Reduzierung der Verpackungsvielfalt
- Weniger Lagervolumen

Nutzen

- Bewährtes Verpackungssystem
- Hohe Kostenersparnis
- Gewinn an Lagerfläche



Platinen

Anwendungsbereich
Embedded Systems



Die Technik

- Der spezielle Klapp-Mechanismus sorgt dafür, dass die Spannfolie Ihr Produkt fest auf das Wellpapp-Format fixiert. Ein Verrutschen wird somit vermieden.
- Die hochflexible aber praktisch reißfeste Spannfolie schmiegt sich dabei den verschiedensten Produkt-Konturen perfekt an.
- Das reduziert ihre Vielfalt um bis zu 90%.

Hauptmerkmale

- Hoher Schutz für verschiedenste Produkte und Konturen
- Reduzierung der Verpackungsvielfalt um bis zu 90%
- Schnelles Handling durch Umkartons mit Automatikboden
- Senkung der Prozesskosten (Beschaffung, Lagerung, Versand)
- Umweltverträglich, da ungetrennte Entsorgung mit dem Altpapier möglich
- Professionelle Optik
- Wirtschaftlich durch Standardprogramm (keine Werkzeugkosten)

Bereits bewährte/vorhandene Verpackungslösungen:

Versandgut max.

160 x 100 x 20 mm

190 x 120 x 30 mm

u.v.m.

Artikel- Code

FL161002ESDS

FL191203ESQ

Selbstverständlich entwickeln wir auch kundenspezifische Verpackungen passend für Ihre Produkte.

Die optimale Lösung bekommen Sie bei uns. Sprechen Sie uns an!
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.